

第二十四届中国覆铜板技术研讨会

邀请书

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会覆铜板分会，拟定于2023年12月6日至12月8日，在浙江省桐乡市“振石大酒店”举办“第二十四届中国覆铜板技术研讨会”。

当前，国际形势复杂严峻，国内市场需求不足，国内外新市场、新技术竞争更为激烈，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，覆铜板产业创新突破高质量发展处于关键时期，产品技术迭代升级，创新突破，产业链上下游需携手共进、深度融合、精诚协作，共同推进覆铜板产业技术进步，促进产业链高质量健康发展。

本届研讨会的主题为“**协同创新破难点 促进产业链高质量发展**”。大会将邀请覆铜板行业及其上下游企业、科研院所的知名专家，就覆铜板技术及产业链的热点作深入探讨和精彩演讲，还有来自国内覆铜板行业及上下游行业的专家、技术人员呈献的优秀论文。大会召开期间，将隆重颁发本届研讨会的“CCLA杯优秀论文奖”。

热忱欢迎覆铜板行业及上下游企业代表、业界人士届时光临。

热忱欢迎关注覆铜板产业发展的各界人士、机构光临此盛会。

主办单位及联络资讯：

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会覆铜板分会 李 琼 021-54179011-605

承办单位：

中国巨石股份有限公司

协办单位：

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

广东省电路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

江西省电子电路行业协会（JXPCA）

重庆市电子电路制造行业协会 (CQPCA)

赞助单位：（征集中）

中国巨石股份有限公司
山东圣泉新材料股份有限公司
南通凯迪自动机械有限公司
浙江华正新材料股份有限公司
广东盈华电子材料有限公司
合肥井松智能科技股份有限公司
彤程新材料集团股份有限公司
广东龙宇新材料有限公司
同宇新材料（广东）股份有限公司
南通图海机械有限公司
成都科宜高分子科技有限公司
江苏东材新材料有限责任公司
梅州市威利邦电子科技有限公司
广东亚镭环境科技股份有限公司
上海开士达化工新材料有限公司
安徽新远科技股份有限公司
浙江双元科技股份有限公司
上海村田激光技术有限公司
江西省航宇新材料股份有限公司
亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司
苏州巨峰新材料科技有限公司
珠海镇东有限公司
咸阳威迪机电科技有限公司
建滔积层板控股有限公司
陕西宝昱科技工业股份有限公司
广东生益科技股份有限公司
天津市云威科技有限公司公司
诺泽流体科技（上海）有限公司
无锡伟一不锈钢有限公司

苏州锦艺新材料科技股份有限公司
汕头超声覆铜板科技有限公司
江西省宏瑞兴科技股份有限公司
河南神玖天航新材料股份有限公司

• • •

会议日程:

“第二十四届中国覆铜板技术研讨会”：会期 2023 年 12 月 6 日~8 日。12 月 6 日全天报到，12 月 7 日全天报告（8:30~18:00），12 月 8 日上午参观中国巨石股份有限公司，下午疏散。

会议费用:

费用包括: 会务费、资料费、餐饮费等。

会费标准: 已交会员费单位 1500 元/人，未交会员费单位代表及非会员单位代表 2000 元/人。参会代表可提前将会务费汇至协会账户，如参会人员有变动，会后办理退费或报到现场补交。

住 宿: 参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间，标间 380 元/晚/间（含双早），单间 450 元/晚/间（含双早），费用自理。

预定住宿联系人: 陆锦芬 电话: 138 6739 8426。

付款方式:

帐 户: 中国电子材料行业协会

开户银行: 工行北京香河园支行

账 号: 0200 0191 0900 0125 724

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

会议地址:

桐乡市振石大酒店，地址：浙江省桐乡市梧桐街道振兴东路 199 号。

酒店联系电话: 0573-88188888 。

会议酒店交通指南:

飞 机: 萧山国际机场，65 公里。

高 铁: 桐乡高铁站，12 公里；

会务组联络方式:

联系人：王晓艳 13609146084 ， 029-33335234

董榜旗 15667263899

协会微信：15667246308

E-mail: ccla33335234@163.com

网 站：www.chinaccl.cn

第二十四届中国覆铜板技术研讨会组委会

2023年11月9日

“第二十四届中国覆铜板技术研讨会” 会议回执

单位名称					订房数量	
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail	单人间	双人间
开票信息： 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 发票邮寄地址：						
备注	房源有限，计划在“振石大酒店”住宿的代表，务请于2023年12月01日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板行业协会会议”，即可享受优惠价格。 酒店预定房间联系人： 陆锦芬 电话：138 6739 8426。 1. 请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于11月30日前发至 ccla33335234@163.com 或协会微信：15667246308 。 2. 需要了解研讨会最新动态请登录：www.chinaccl.cn 或者直接联系会务组。					

会议日程表

时间	报告地点、报告人及报告题目	主持人
报告地点（酒店二楼 玉石厅）		
12月7日 上午8:30~12:00	中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 理事长 郭江程 致开幕词	待定
	中国电子电路行业协会覆铜板分会 会长 陈仁喜 致词	
	浙江省桐乡市领导 致词（待定）	
	中国巨石股份有限公司领导 致欢迎辞	
	颁发 2023 年“CCLA 杯优秀论文奖”	
	【特邀报告】 中兴通讯股份有限公司 总工程师 聂富刚 通讯产品高速演进的 PCB 材料需求及应用技术	
	【特邀报告】 《印制电路资讯》杂志副主编 CCLA 覆铜板技术委员会委员 中国电子电路行业协会标委会委员 研究员级高级工程师 杨维生 现代通讯下 PCB 产业链的协同和创新	
	【特邀报告】 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 高级顾问教授级高工 师剑英 重塑环氧玻纤布基覆铜板	
	中国巨石股份有限公司 电子玻纤中心产品研发部部长 电子布技术副主任工程师 博士、高级工程师 马哲 覆铜板用高质量电子玻纤布解决方案	
浙江华正新材料股份有限公司 工程师 魏俊麒 6G 潜在关键技术对材料发展的启示		
毕克助剂(上海)有限公司热固性塑料经理 黄刘应 毕克助剂覆铜板应用解决方案		
12:00~13:30 午餐（自助餐 酒店一楼 克利斯西餐厅）		董榜旗 徐卫军
覆铜板技术报告专场（酒店二楼 玉石厅）		
12月7日 下午13:30~17:30	瑞谱分析仪器（天津）有限公司 销售经理 韩学琴 在线检测半固化片解决方案	杨中强
	广东生益科技股份有限公司，国家电子电路基材工程技术研究中心 工程师 李志光 5G 射频 PA 模组用 Low Loss & Low CTE 封装基板材料的开发	
	广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 中国科学院长春应用化学研究所 博士 杨正慧 基于低介电损耗聚酰亚胺的挠性覆铜板结构与性能	
	西安交通大学 微电子学院 博士、副教授 向锋 Sub-6G 频段内薄膜介质材料微波介电性能测试方法研究	
	广东生益科技股份有限公司，国家电子电路基材工程技术研究中心 工程师 罗成 超低介电损耗、超低 CTE 的高耐热 CCL 的开发	
	中兴通讯股份有限公司 工艺研发资深专家 魏新启 6G 天地互联及云计算对覆铜板的机遇和挑战	
【特邀报告】 国家电子电路基材工程技术中心、广东生益科技股份有限公司 首席技术专家 覆铜板行业技术委员会 主任 杨中强 覆铜板电子电路基材及其 PCB 绝缘可靠性的技术探讨		
覆铜板原材料报告专场（酒店五楼 紫晶厅）		
12月7日 下午13:30~16:30	江西省航宇新材料股份有限公司 工程师 徐玉莹 一种高耐热 360° LED 发光用超透光覆铜板的开发	沈宗华
	四川东材科技集团股份有限公司 工程师 邹静 有机硅改性双马来酰亚胺树脂合成及性能研究	
	辽宁科技大学 博士 教授 胡君一 高频高速覆铜板用聚萜烯树脂的研究与应用	
	四川东材科技集团股份有限公司 西南科技大学 研究生 张坤 低介电损耗乙烯基树脂合成及性能研究	
	九江德福科技股份有限公司夸父实验室项目开发主管 博士 张杰 第三代超低轮廓电解铜箔 V-HS3 性能研究	
	山东圣泉新材料股份有限公司 工程师 边均娜 高导热液晶环氧的发展与应用	
12月7日	18:30 中国巨石股份有限公司 招待晚宴（酒店五楼 紫晶厅）	徐卫军
12月8日	上午 9:00~11:00 参观中国巨石股份有限公司或返程	